

**TCL 科技集团股份有限公司****关于与协鑫集团签署合作框架协议的公告**

**TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

**特别提示：**

- 1、协议的签署预计不会对公司本年度经营成果造成重大影响。
- 2、协议仅为合作各方意向性约定，公司将根据相关法规的规定及项目进展及时履行信息披露义务。

**一、概况**

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）聚焦于半导体显示、半导体光伏及半导体材料的核心科技产业发展，因应国家“碳达峰、碳中和”战略目标，进一步推动企业绿色高质量发展，实现公司半导体光伏及半导体材料业务领先的战略目标，公司及公司控股子公司天津中环半导体股份有限公司于近日与协鑫集团有限公司及协鑫科技控股有限公司签署了《合作框架协议书》，现将相关情况公告如下。

**二、协议各方基本情况**

协议除本公司外签署方基本情况如下：

**1、天津中环半导体股份有限公司**

统一社会信用代码：911200001034137808

注册资本：323173.3699 万元人民币

公司住所：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号

公司性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：沈浩平

成立时间：1988 年 12 月 21 日

经营范围：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；太阳能电池、组件的研发、制造、销售；光伏发电系统及部件的制

造、安装、销售；光伏电站运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系说明：其系公司控股子公司

## 2、协鑫集团有限公司

协鑫集团有限公司为一家注册于香港的有限责任公司。

联系地址：香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场 17 楼 1703 B-1706 室

经营范围：风光储氢、源网荷储一体化，新能源、清洁能源、移动能源产业新生态，硅材料、锂材料、碳材料、集成电路核心材料等的研发与生产。

关联关系说明：公司与其不存在关联关系。

## 3、协鑫科技控股有限公司

协鑫科技控股有限公司为香港联合交易所有限公司主板上市的公司（股票简称：保利协鑫能源，股票代码：03800）。

联系地址：香港九龙柯士甸道西一号环球贸易广场 17 楼 1703-1706 室

经营业务：全球领先的高效低碳光伏材料研发和制造商，主要从事太阳能级多晶硅和硅片的研发，制造和销售业务。

关联关系说明：公司与其不存在关联关系，协鑫集团有限公司为其主要股东。

## 三、协议的主要内容

协议签署各方：

甲方：TCL 科技集团股份有限公司

乙方：天津中环半导体股份有限公司

丙方：协鑫科技控股有限公司

丁方：协鑫集团有限公司

### 1、合作目的

2022 年 4 月 7 日甲方、乙方分别与内蒙古自治区人民政府和呼和浩特市人民政府签署了内蒙古中环产业城项目群有关合作协议，拟在公司原有产业基地的基础上进一步打造形成内蒙古中环产业城，建成具备国际竞争力、国内最重要的单晶硅材料制造产业基地。

各方本着平等互利、资源共享、优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，就关于在内蒙古呼和浩特市合作投资新建光伏级和电子级硅料项目，达成本合作框架协议书，并为今后进一步深入合作建立坚实基础达成共识。合作期间各方将充分发挥各自的优势和资源，坚持互惠共赢、同等优先的原则，不断拓展合作领

域，提高合作水平，构筑良性互动、共同发展的新格局。

## 2、项目主要合作内容及原则

(1) 各方拟就约 10 万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目（下称“光伏多晶硅项目”）、约 1 万吨电子级多晶硅项目（下称“电子级多晶硅项目”，与光伏多晶硅项目合称“合作项目”）进行战略合作。

(2) 光伏多晶硅项目：由甲方、丙方或其各自控股子公司在内蒙古呼和浩特投资设立一家合资公司实施，总投资预计为 90 亿元，甲方、丙方或其各自控股子公司在合资公司中的股权比例拟定为 40%、60%。

(3) 电子级多晶硅项目：由甲方、丙方关联方在内蒙古呼和浩特投资设立一家合资公司实施，总投资预计为 30 亿元，甲方、丙方关联方在合资公司中的股权比例拟定为 40%、60%。

(4) 乙方承担日常联络工作，协调上述合作项目落户中环产业城，并依照与当地政府有关合作协议约定享受项目优惠政策。

## 3、其他事项

本框架协议合作内容不对任何一方构成具有法律约束力的义务，且相关协议内容的实施以各方分别取得各自适当机构之批准为前提。

## 四、对公司的影响

公司立足科技制造产业的发展，按照“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的工作要求，持续增强在半导体显示、半导体光伏及半导体材料领域的竞争优势。公司半导体显示业务在巩固大尺寸领先优势的基础上向全尺寸领先迈进；半导体光伏业务的 G12 大硅片在产能规模、技术工艺、生产效率实现全面领跑，市占率稳居全球第一，具备专利优势的叠瓦组件亦快速上量；半导体材料业务通过特色工艺和先进制程双路径发展，8-12 英寸半导体硅片产销增量显著。

为把握能源结构调整和经济转型机遇，推动企业绿色高质量发展，增强公司在半导体光伏及半导体材料产业的战略领先优势，公司及子公司中环半导体股份有限公司拟在原有产业基地的基础上进一步打造形成内蒙古中环产业城，建成具备国际竞争力、国内最重要的单晶硅材料制造产业基地。

通过本项目的建设，公司将实现在半导体光伏及半导体材料上游核心多晶硅材料的业务布局，有利于实现产业链战略协同降本，强化供应链稳定性，助力实现公司“半导体光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”。

## 五、风险提示

- 1、协议的签署预计不会对公司本年度经营成果造成重大影响；
- 2、协议签署前三个月公司持股 5%以上股东及董监高持股未发生变化。截止本公告日，公司未收到持股 5%以上股东及董监高股份减持意向；
- 3、协议仅为合作各方意向性约定，其他未尽事宜尚需履行相应决策程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 19 日